

プロジェクトレビュー ITER 計画の機器開発・製作の進展

5. ITER NBTF 電源高電圧機器の製作

5. Manufacturing of the ITER NBTF Power Supply Components

渡邊和弘,前島哲也,柏木美恵子,戸張博之,柴田直樹, 山中晴彦,照沼勇斗,梅田尚孝,大楽正幸,花田磨砂也 WATANABE Kazuhiro, MAEJIMA Tetsuya, KASHIWAGI Mieko, TOBARI Hiroyuki, SHIBATA Naoki, YAMANAKA Haruhiko, TERUNUMA Yuto, UMEDA Naotaka, DAIRAKU Masayuki and HANADA Masaya *国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

(原稿受付:2016年1月13日)

ITER 計画の下,実機と同一性能の ITER 中性粒子入射装置 (NBI) 実機試験施設 (NBTF) をイタリア・パドバ の RFX 研究所に建設している.この計画では直流 1 MV,60 A,1 時間連続出力の NBI 電源システムの製作を原 子力機構と EU で分担している.原子力機構は直流 1 MV の超高電圧電源の主要機器を担当しており,これまでに 200,400,600 kV 部の直流発生器の製作を完了した.また,全長が 100 m におよぶ 1 MV トランスミッションライ ンの80%を完成させた.これらを第 1 便として RFX 研に輸送し,2015年12月から据付け工事を開始した.

Keywords:

ITER, neutral beam, NB, NBTF, 1 MV dc ultra-high voltage, 1 MV insulating transformer, power supply

5.1 はじめに

ITER (国際熱核融合実験炉) プラズマの加熱と定常維持 のためのプラズマ電流駆動装置の一つである中性粒子ビー ム入射装置 (NBI; Neutral Beam Injector) には、これまで のトカマク装置に必要とされたビームのエネルギーの2倍 にあたる1 MeV という高エネルギーで, かつ中性粒子ビー ムの一次粒子である負イオンビームも単機あたり40A, そ して発生パルス幅が3600秒のほぼ定常動作に等しい高い性 能が要求されている. このような NBI 装置に先立って、イ タリア・パドバのコンソルツィオ RFX 研究所に実機と同 一性能のNB実機試験施設(NBTF)を建設することが2009 年12月の ITER 理事会で承認された. 日本原子力研究開発 機構(原子力機構)は、ITER 機構や NBTF 建設サイトで ある RFX 研究所と機器の要求性能やインターフェース条 件の協議を進め,調整合意しながら ITER 機構, EUと共同 で機器の統合設計報告書を取りまとめた. これを受けて、 日本と ITER 機構の間で2012年2月に調達取決めを締結し た.

NBTFは日本とEUで分担して製作する試験施設[1]であ り,原子力機構は装置の中でも主要な部分である直流 1 MV の超高電圧機器の製作を担当し[2],EU は電源の低 電圧側や制御系,ビームライン,ビーム源(負イオン源及 び加速器)を担当する.原子力機構は日本の国内機関とし て,機能仕様を定めた調達取決めに従い,メーカと設計・ 製作の契約を2012年10月に締結した.その後,機器毎に最 終設計報告書を作成して2013年7月から2014年10月までに *現在の所属:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 順次 ITER 機構において最終設計レビューを行い ITER 機構の承認を経て機器の製作を進めてきた.

これまでに, 試験用電源 (TPS 1.3 MV, 10 mA 連続), 直流 1 MV の超高電圧発生器を構成する機器の一部である 3 台の直流発生器 (DCG),及び1 MVの出力をビーム源ま で送電する伝送ライン (TL:トランスミッションライ ン)全長約 100 m の内80%の製作と工場試験を完了させ た.2015年10月時点で,日本が担当している超高電圧電源 機器14基のうちの6基の製作が完了し,2015年10月に第1 便として日立港からイタリア・パドバへ輸送し,12月から 現地での据付けを開始した.

本章では、NBTF 電源システムの概要と原子力機構の分 担機器について説明し、機器の性能や工場での試験結果の 主要なものを紹介する.

5.2 NBTF 電源システムの構成と特徴

図1にNBTF電源装置の全体図を示す.図面右端に各段 直流200kV出力の昇圧変圧器と整流器から構成される直 流発生器(DCG)5台が設置される.これらDCGからの 200,400,600,800,1000kVの出力は,過電圧抑制とリッ プル低減のためのフィルターコンデンサ(DCF)に接続さ れる.安定化された出力は,伝送ライン(TL1,2)によっ てビーム源まで伝送される.伝送ラインは,DCGの整流器 部からDCFを通して各段200kVの電圧差毎の導体を内部 に有しており,絶縁ガスである六フッ化硫黄(SF₆)ガス 0.6 MPa(絶対圧力)で満たされ各導体の絶縁がなされる.

· 国立切九册光伝八里1 将子我附切九册光候博

corresponding author's e-mail: watanabe.kazuhiro@qst.go.jp

Project Review

ビーム源にて負イオンを生成して引き出すための電源は, 図1中央の箱型の静電シールドで覆われた高電位デッキ1 (HVD1)内に設置される.HVD1の調達はEUが担当する が,これに電力を供給する1MV絶縁変圧器は日本が供給 する.HVD1は,負イオンを-1MVの高電位上で発生して 接地電位まで加速するために,直流-1MVの絶縁がなさ れた構造であり,絶縁支柱で地面から絶縁される.供給す る電力も接地電位から絶縁する必要があり,直流1MV絶 縁変圧器が不可欠となる.この絶縁変圧器は,一次-二次 巻線間で直流1MVを3600秒の長時間絶縁することが必要 であるが,これまでに製作実績が無いため電源機器製作に おける大きな開発課題の一つであった.そこでNBTF実機 変圧器の製作設計の前にITER 機構から受託研究を受けて 試作試験を実施した[3].

交流(または直流短時間)の電圧印加時には、変圧器の

内部絶縁体(多層油浸紙絶縁体)である絶縁紙と絶縁油の 間の電圧分担が静電容量によって決まるのに対し,長時間 の直流印加時には,数千秒の時定数で多層油浸紙間の静電 容量による電圧分担から抵抗値による電圧分担に移行す る.このため直流長時間の電圧印加時には抵抗値の高い絶 縁紙に高い電圧が掛かるようになる.この時間変化による 絶縁紙への電圧の集中を防止し絶縁破壊を防ぐため,直流 長時間の変化を考慮して絶縁層の寸法や構造を決定した.

さらに二次巻線出力の電位は-1 MV であり,引き出し ブッシングは対地との絶縁が必要である.交流 1 MV を絶 縁できる碍子製コンデンサブッシングは既に開発されてい るが,本電源に必要な直流 1 MV の長時間絶縁に使用する ためには,碍子の大きさが直径約 2 m,高さ約 10 m となり (図2 左図),これまでに無い巨大な碍子が必要となるとと もに,構造の改善も必要となり製作には多大な困難が予想



図2 従来型ブッシングと新たに開発した複合型ブッシングの比較.

された.

そこで、小型の碍子製コンデンサブッシングに繊維強化 プラスチック (FRP) 絶縁円筒を被せた碍子 / FRP の二重 複合型ブッシングを考案し、新たに開発した(図2右図). FRP (図中(a))の内側には絶縁ガスである SF₆ガスを充填 する(b).絶縁変圧器の二次巻線出力(d)は碍子製ブッシン グ(c)の下端と油絶縁領域で接続され、碍子製ブッシング の頂部端子はSF₆ガス中でFRP製絶縁円筒の頂部出力端子 と接続される.FRP 絶縁円筒の内部は SF₆ ガス,外側は大 気(e)で絶縁される.大気側については, FRP 表面の沿面 絶縁距離を十分に取る構造とした. このようにコンデンサ ブッシングで油 - ガス絶縁を行い, FRP 絶縁管でガス - 大 気絶縁を行うように役割を分担する二重複合ブッシング構 造として、さらに電界解析を実施して可能な限り一様な電 界分布となるように構造詳細を決定した. その結果, 内部 の碍子製コンデンサブッシングは,直径1m以下,高さ4m 以下となり、重量は1/10程度まで小型化を実現した.この ように、1 MV の直流超高電圧に使用できる絶縁ブッシン グを技術的に実証するだけでなく、同時に大幅な低コスト 化と軽量化に成功した[3].図3に開発した直流1MV絶縁 変圧器の写真を示す.下部が絶縁変圧器本体タンクであ り、垂直に取り付けられているのが複合型ブッシングであ る.

HVD1内に有る負イオン生成と引出しのための電源出力 は,EUが担当するHVD1の絶縁ブッシングを介して対地 絶縁を保ってTL2内の1MV電位の導体に導入される. HVD1の電源出力導体・ケーブル等及びDCGからの中間 電位導体の配置は,電界解析を行いTL2の限られた空間の 中でも電界集中が起らない様各導体を最適配置にした.

直流高電圧が印加される加速器で絶縁破壊を完全に抑制 することが困難なため、NBIの設計では従来から絶縁破壊 が発生することを許容する設計としている.つまり、絶縁 破壊が発生して電源の負荷端が短絡してもそれを故障とは せず、短絡電流を数百マイクロ秒で高速に遮断し、一定時 間経過後に電圧を再印加してビーム入射を継続する機能が 要求されている.絶縁破壊の連続発生を抑制するには、絶



図3 直流1MV 絶縁変圧器試作器.

縁破壊による加速器の損傷を防ぐことが必要である.加速 器の損傷は,絶縁破壊時に流入するエネルギーや電流に依 存するため,それらを抑制することが必要である.このた めに,電源の浮遊静電容量を小さくすることで流入エネル ギーの素を小さくすること,さらに,流入エネルギーを吸 収して,加速器の損傷を防ぎ絶縁破壊が発生したとしても 耐電圧の低下が無い,つまり絶縁破壊が連続して起らない ようにすることが NBI 電源に課された大きな課題である.

NBTF電源設備において加速器への流入エネルギーを吸 収するために、コアスナバーがTL2の終端部に設置される が、従来のフェライトコアでは飽和磁束密度が低いため に、必要なコアが膨大となる.また、周波数特性が悪く MHzの高周波では透磁率が低下して必要な性能が得られ ない.そこで、MHzオーダーの高周波サージにおいても サージ抑制に必要とする透磁率や電圧時間積(V・s)を持た せることが可能なファインメット®コアを用いている[5].

TL2の終端部でビーム源の手前には、ビーム源に純水冷 却水を絶縁して供給するためのウォータチョークとガス導 入系を内蔵する HVD2 が接続される.純水冷却系の中には イオン源の電極を高温に保つために150℃の高温水を1 MV の高電位部に供給する必要がある.純水は温度上昇によっ て導電率が上昇するが、100℃以上の高温領域では十分な データが無く、暗電流の過剰な増加やそれに伴う絶縁性の 低下などが懸念された.そこで、セラミック管による絶縁 体モデルを使用して高温高圧水を流し、180℃までの高温 領域について、抵抗率と耐電圧性能を確かめ設計に反映さ せた[6].

SF₆絶縁ガスが満たされている TL 終端部と真空領域で あるビーム源との間には原子力機構が供給する HV ブッシ ングが接続される.これは,-1 MV電位にある種々の導体 と 200 kV 毎の電位差のある 5 段加速器への電圧をそれぞ れ絶縁して,ガス絶縁領域から真空領域へ導入する隔壁型 ブッシングである.なお,ブッシングの絶縁体は内側つま り真空側が大型のアルミナセラミック円筒,外側つまり SF₆ガス側が FRP 円筒絶縁体で構成されている[3].その 中間層には圧縮した乾燥空気を流す.これは,中間層を設 けることによりトランスミッション側の SF₆ガスがイオン 源真空側に流入することを検出し防止するためである.

5.3 電源機器製作の状況

5.3.1 DCG の製作と試験

直流発生器(DCG)には EU が用意する 150 Hz のイン バータによる三相高周波交流が供給される.DCGの昇圧変 圧器の三相交流出力は変圧器の上部に設置された三相全波 整流器に接続され直流 200 kV が出力される.

図4に昇圧変圧器(400 kV 部用)の耐電圧試験の様子を 示す.耐電圧試験は,DCG 全体としては困難なため昇圧変 圧器と整流器に分けて実施した,変圧器の二次出力部に試 験電圧印加用のブッシングを取り付けて実施し,規定の値 すなわち定格の120%である480 kV,1時間保持を確認し た.整流器部についても,図5に示すように変圧器への接 続ブッシング部を介して試験電圧480 kVを印加し,絶縁を 確認した.

また,これら昇圧変圧器と整流器を組み合わせての直流 出力動作試験を実施し,150 Hz インバータ電源から供給し た高周波交流が整流されて正常に出力することを確認し た.図6に昇圧変圧器と整流器を組み合わせた写真を示 す.大型の整流器を支えるために支持構造体を用いてい



図4 昇圧変圧器の耐電圧試験.



図5 DCG 整流器部の耐電圧試験.

る.NBTFではこのような形状のDCGを5台設置して 1 MV 電源を構成する.

5.3.2 トランスミッションラインの製作と試験

1 MV, 60 A, 3600秒の電源の出力を負荷であるビーム 源まで安定安全に送電するのがトランスミッションライン (TL)である. 図7にトランスミッションラインの一部の 直流耐電圧試験の様子と断面構造を示す. 左側の写真は, 電源機器の製作で機器の耐電圧試験に使用するための直流 高電圧試験装置(TPS:最高電圧1300 kV, 10 mA 連続出 力)にトランスミッションラインの10 m分を接続して試験 を実施している様子である. トランスミッションラインと TPS 内部には,耐電圧が最も厳しい条件である絶縁ガス圧 力,すなわち NBTF 運転条件における最低ガス圧と同様に



図6 DCG として組み立てた様子.



図7 トランスミッションラインの耐電圧試験と内部構造.



図8 HV ブッシング断面構造.

SF₆絶縁ガス 0.55 MPa を封入した.各中間電位導体には,TPS の出力部に設けてある抵抗分圧器によりそれぞれ200 kV 毎の異なる電圧を発生させ同時に印加可能である,

試験の結果, ITER で要求される 1200 kV, 1 時間の安定 な電圧保持を確認した. さらに, NBTF 電源システムの異 常時に発生する過電圧を想定した試験である印加電圧変動 試験を実施した.この試験では,定格運転電圧 1000 kV から過電圧の 1265 kV に数秒間で上昇させ1分間保持した 後定格電圧に戻し,これを5回繰り返し絶縁破壊等の異常 の無いことを確認した.その後,トランスミッションライ ンの残りの部分の耐電圧試験を継続した.

5.3.3 HV ブッシングの製作

HV ブッシングはトランスミッションラインの終端部に 取付けられ,各種の電源出力導体の絶縁とSF₆ガス領域と 真空領域を分離するものである.図8に断面構造図を示 す.これまで,大型セラミックの開発を初めとし,大面積 多層構造の真空中電極の耐電圧特性を明らかにするなど, R&Dと設計を重ねて実現したものである.

図9に,製作したHV ブッシングの外側面(SF₆領域側) の構造を示す.5段に重ねた絶縁リングと各電位のビーム 加速電極部に供給する冷却水配管が取り付けられている. 図10にはHV ブッシングの真空側から見た写真を示す.各 電位を分担し,冷却水をビーム源に導入する配管をサポー トし,電圧を保持するためのスクリーン電極の端部が見え る.今後,1MVの耐電圧性能を確認した後,パドバの NBTF サイトへ輸送する計画である.



図9 HV ブッシングの外部構造.



図10 HV ブッシング内部.

5.3.4 輸送及び現地据付け工事の開始

製作試験の完了した電源機器は、順次4回に分けてパド バまで輸送する.第一便の主要な機器は、200kV,400kV, 600kVのDCGとトランスミッションライン1,さらにト ランスミッションライン支持構造体を中心とする大型機器 である.図11にRFX研究所に到着したDCGの昇圧変圧器 の写真を示す.予定通り12月中旬から機器の据付工事を開 始した.図12にトランスミッションラインの一部の据付け の様子を示す.

5.4 まとめ

1 MeV, 40 A, 3600秒の負イオンビームを発生させる ITER NB 実機試験施設(NBTF)用高電圧電源機器の製作 を実施している.日本での製作試験完了に従い,イタリ ア・パドバ RFX 研究所に4回に分けて輸送する.第1便 は,200,400,600 kVの直流発生器と全長100 mの伝送ラ インの8割であり,2015年12月初旬にRFX研究所のNBTF サイトに到着した.中旬から予定通り据付け工事を開始し た.



図11 イタリア・パドバ RFX 研究所に到着した DCG 昇圧変圧器.



図12 トランスミッションラインの据付け.

参考文献

- [1] V. Toigo *et al.*, Fusion Eng. Des. **88**, 956 (2013).
- [2]前島哲也他:"19-096 ITER中性粒子入射装置用電源 の超高電圧絶縁設計と開発"第10回核融合エネルギー 連合講演会(つくば, 2014).
- [3] H. Tobari *et al.*, *Proc. Symposium on Fusion Engineering* (SOFE) May 31-June 4, 2015, in Austin, Texas USA.
- [4] K. Watanabe et al., Nucl. Fusion 46, S-332 (2006).
- [5] K. Watanabe et al., Rev. Sci. Instrum. 69, 4136 (1998).
- [6]山中晴彦他: "純水の高温領域における抵抗率変化特 性の測定", JAEA-Technology 2014-037.